



EV Group präsentiert die neueste Generation der EVG®120 Resistverarbeitungsplattform für die Hochvolumenproduktion

Die neue ultrakompakte Plattform bietet die Leistung der EVG150-Systeme, In-situ-Messung der Resist-Schichtdicke sowie Waferrandbelichtung in einem kompakteren, hochflexiblen Format.

ST. FLORIAN am Inn, Österreich, 18. Februar 2026— EV Group (EVG), ein führender Anbieter von innovativen Prozesslösungen und Know-how zur Umsetzung zukunftsweisender Halbleiterdesigns und Ansätzen zur 3D-Integration von Mikrochips, stellte heute eine neue Generation des automatisierten Resist-Verarbeitungssystems EVG®120 vor – eine umfassende Weiterentwicklung einer der führenden Belackungs-/Entwicklungsplattformen des Unternehmens. Mit einer neuen kompakten Architektur, bahnbrechenden Funktionen und konstruktiven Verbesserungen, die aus dem stark nachgefragten EVG150-System übernommen wurden, weist die neue Generation des EVG120 einen deutlich höheren Durchsatz, größere Flexibilität und eine verbesserte Prozesssteuerung auf. All dies bei einem geringeren Platzbedarf, optimiert für Kunden mit einer großen Produktvielfalt und Resist-Prozessen, die ein Höchstmaß an Flexibilität erfordern.

Die neue Generation des EVG120 eignet sich ideal für Advanced Packaging, MEMS, Bildsensoren, Photonik, Leistungshalbleiter, Wafer-Probecards und andere schnell wachsende Anwendungsbereiche und unterstützt die Spin- und Sprühbelackung sowie Entwicklung von Fotolacken, die in der Fotolithographie verwendet werden. Das System unterstützt eine Vielzahl von Substrattypen und -größen (von 2 Zoll bis zu 200 mm) und eine Vielzahl von Resistmaterialien. Dazu gehören dünne, dicke, positiv und negativ zu verarbeitende Resists, dielektrische Materialien wie PI und PBO sowie Schwarz-/Farb-/IR-Resists für Spezialanwendungen.

Spezialisten von EVG werden auf der SPIE Advanced Lithography and Patterning (SPIE-AL+P) Konferenz, die vom 22. bis 26. Februar in San Jose, Kalifornien, stattfindet, über die EVG120-Plattform der nächsten Generation und andere innovative Prozesslösungen in der Lithographie informieren.

Neue Plattform, neue Möglichkeiten

Der neue EVG120 wurde auf Basis einer kompakten 200-mm-Plattform entwickelt, die bis zu zwei Nassprozessmodule und 14 Bake/Chill-Einheiten integriert – eine Steigerung der Kapazität gegenüber der Vorgängergeneration um 40 Prozent. Die Platzanforderungen des Systems wurden um mehr als 20 Prozent reduziert, gleichzeitig ermöglichen Designverbesserungen einen leichteren Zugang bei Wartungsarbeiten und eine flexible, modulare Konfiguration.

Das System bietet gegenüber der Vorgängergeneration außerdem eine Reihe neuer Funktionen, wie zum Beispiel:

- **Wafer Edge Exposure (WEE)** – ermöglicht die selektive Belichtung der Ränder für verbesserte Präzision und Gleichmäßigkeit
- **In-situ-Messung der Resistdicke** – ermöglicht Prozessüberwachung in Echtzeit für höhere Ausbeute und verbesserte Prozesskontrolle (Messbereich: 50 nm bis 50 Mikrometer)
- **Verbessertes Dosiersystem für hochviskose Materialien** – Hochdruckdosierung mit Closed-Loop-Feedback sorgt für präzise Beschichtungsleistung bei dicken Fotolacken
- **Unterstützung von SMIF-Loadports** – macht das Handling der Substrate sauberer und effizienter
- **Standby-Modus** – reduziert den Energieverbrauch im Leerlauf gemäß der SEMI-Norm E167



Diese neuen Funktionen bauen auf den bewährten Belackungstechnologien von EVG auf, wie beispielsweise dem innovativen CoverSpin™-Design, das hervorragende Gleichmäßigkeit gewährleistet und den Materialverbrauch reduziert, sowie der firmeneigenen OmniSpray®-Technologie für die konforme Sprühbelackung, die eine optimale Beschichtung von Oberflächen mit komplexen Topografien und empfindlichen Substraten ermöglicht.

„Die neue Generation der EVG120-Plattform nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von EV Group im Bereich Fotolackverarbeitungen und Lithographieverfahren, um den sich rasch verändernden Anforderungen unserer Kunden von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Serienfertigung gerecht zu werden“, erklärte Dr. Thomas Glinsner, Corporate Technology Director bei EV Group. „Mit den neuen Funktionen wie der In-situ-Messung und Waferrandbelichtung sowie den von unserer EVG150-Plattform übernommenen Features bietet das neue EVG120-System eine unübertroffene Kombination aus Belackungs- und Entwicklungsleistung, Durchsatz, Flexibilität und Betriebskosten in einer kompakten, für den Produktionsbetrieb konzipierten Plattform.“

Besuchen Sie EVG auf der SPIE Advanced Lithography

Teilnehmer der SPIE-AL+P, die mehr über die EVG120-Plattform der nächsten Generation und weitere innovative Lithographie-Prozesslösungen von EVG erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, vom 24. bis 25. Februar den Stand Nr. 616 im San Jose Convention Center in San Jose, Kalifornien, zu besuchen. Darüber hinaus sind EVG-Spezialisten in diesem Jahr mit folgenden Beiträgen im technischen Programm der Konferenz vertreten:

- **“High aspect ratio copper pillar structures enabled by digital lithography patterning of thick resists for AI and HPC device packages”** (Mittwoch, 25. Februar, 8:10–8:40 Uhr, Raum 211B) – präsentiert von Dr. Ksenija Varga, Business Development Manager, EV Group; in Zusammenarbeit mit JSR Micro und TECHNIC France
- **“Lithography digitalization in semiconductor technologies through advanced software development of high-throughput maskless exposure”** (Donnerstag, 26. Februar, 8:00–8:20 Uhr, Raum 211B) – präsentiert von Alois Malzer, Produktmanager, EV Group
- **“Ultrasonic spray coating combined with maskless lithography for advanced wafer singulation with complex bump geometries”** (Donnerstag, 26. Februar, 9:20–9:40 Uhr, Raum 210C) – präsentiert von Johanna Rimböck, Technology Development, EV Group
- **“Exploration and mitigation of local wafer deformations resulting from direct wafer-to-wafer bonding”** (Mittwoch, 25. Februar, 17:10–17:30 Uhr, Raum 211B) – verfasst in Zusammenarbeit mit ASML und CEA-Leti

Produktverfügbarkeit

EVG nimmt ab sofort Bestellungen für die nächste Generation des EVG120-Systems entgegen und bietet Produktdemonstrationen am Firmensitz an. Für weiterführende Informationen besuchen Sie <https://www.evgroup.com/de/products/lithography/resist-processing-systems/evg120/>



Über EV Group (EVG)

EV Group (EVG) bietet innovative Prozesslösungen und Know-how zur Umsetzung zukunftsweisender Halbleiterdesigns und Ansätze zur 3D-Integration von Mikrochips. Der Leitgedanke bzw. die Vision des Unternehmens, erster in neuesten Technologien zu sein und fortschrittlichste Anwendungen der Mikro- und Nanotechnologie zu unterstützen, ermöglicht den Kunden die erfolgreiche Vermarktung ihrer neuen Produktideen. Die für die Hochvolumenproduktion ausgelegten Produkte der EV Group, zu denen Waferbonding-, Lithographie-, Dünnyafer-Verarbeitungs- und Messtechniksysteme gehören, ermöglichen weitere Fortschritte bei der Skalierung des Halbleiter-Frontends, der 3D-Integration und beim Advanced Packaging sowie bei anderen Elektronik- und Photonikanwendungen. Mehr Informationen unter www.EVGroup.com

Kontakt:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

###